

ハイソル 株式会社



代表取締役社長
吉岡 和幸

東京都
台東区上野1-17-6

1993年(平成5年)設立
03-3836-2800

<http://www.hisol.jp>

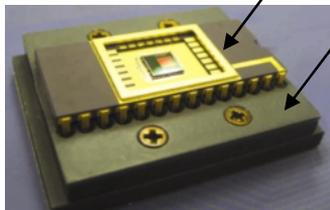
パッケージ、ソケットも
使用しない世界初のEM試
験装置を開発

独自コンタクト技術の開発によりEM試験（半導体素子の配線寿命試験）が、パッケージやソケット、ウエハープローブを使用せずに測定が可能になった。それにより測定までの期間を短縮して環境に優しい試験を安価に行なえる。

ICチップをダイレクトに測定ボードとコンタクトできる独自設計を開発

EM試験には、ウエハからICチップを切り出してパッケージに組立ててから試験をするパッケージタイプと、ウエハのままプローブと呼ばれる細い針で測定するWLRタイプの2種類あるが、同社で開発した新しいEM試験方式は、パッケージもプローブも使用しない簡潔化された構造になっており、時間もコストも最小現に抑え、CO2削減にも貢献。

パッケージ ソケット



従来のEM試験測定ボード



ハイソルオリジナルEM試験ボード



EM受託試験ルーム

自社の新技術によりEM試験の信頼性が向上、環境にも優しい

EM試験では電流の他に温度ストレスをかける為、長時間使用することによりパッケージタイプの試験ではソケットが劣化したり、WLRタイプではウエハが熱により膨張して、プローブがずれてしまう問題があったが、同社の新技術はこれらの問題をすべて解決することに成功した。また、パッケージも不要で廃棄しないで済む為、環境にも優しい。

40年以上の半導体業界経験を活かし、半導体産業を「元気に革新」

当初、同社は輸入販売が中心であったが、「EM試験の信頼性や試験効率の向上を図れないか。」などの意見が数多くのユーザーから寄せられていた。同社はこれら数多くの要求に応える為、自社製品の開発を開始した。今では売上の半分を自社製品が占めており、急速に変化し続ける半導体市場で最先端の製品開発に取組み、社内で設計から組立てまで一貫して行なっている。現在では、「輸入販売」「自社製品開発、販売」の事業に加え、上記に記載した新技術を使った「EM受託試験」も新たな事業として立上げ、順調に数多くのユーザーに利用されている。